

Instrukcja obróbki, montażu i użytkowania Płyt BACKSPLASH SWISS KRONO (gr. 10 mm).

Płyta BACKSPLASH (panel wnąkowy) to produkt drewnopochodny, który ma właściwości higroskopijne wynikające z właściwości surowca, z którego jest wyprodukowany. Oznacza to, że jest materiałem reagującym na zmiany wilgotności środowiska, w jakim się znajduje - pęcznieje w sytuacji, kiedy wilgotność powietrza rośnie i odparowuje wodę, kurcząc się, w sytuacji zmniejszania się wilgotności powietrza.

Budowa Płyt BACKSPLASH:

- materiał bazowy – płyta wiórowa gr. 10 mm
- obie powierzchnie pokryte są laminatem HPL (w różnych dekorach, dopasowanych do dekorów Blatów kuchennych SWISS KRONO)



Przechowywanie i transport

- Płyty BACKSPLASH należy przechowywać poziomo, całą powierzchnią na płaskim, suchym i czystym podłożu.
- Płyty BACKSPLASH należy przechowywać w suchym i zamkniętym pomieszczeniu, w stabilnych warunkach klimatycznych: powyżej 5°C, wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%, w odległości min. 1,5 m od bezpośredniego źródła ciepła.
- Podczas załadunku i rozładunku, płyty BACKSPLASH powinny być podnoszone. Nie należy ich przesuwać ani ciągnąć za krawędź.
- Powierzchnie płyt należy utrzymywać w czystości. Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie (pył, opiłki, piasek, itp.), które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.

WAŻNE: Niewłaściwe przechowywanie może doprowadzić do trwałego odkształcenia płyt BACKSPLASH.

Przygotowanie

- Przed obróbką i montażem zalecamy aklimatyzację płyt BACKSPLASH do temperatury pokojowej. Zaleca się min. 24h sezonowanie ich w pomieszczeniu gdzie będą zamontowane.
- Płyty BACKSPLASH należy montować i użytkować w pomieszczeniach ogrzewanych, zamkniętych i wentylowanych, gwarantujących ich zabezpieczenie przed wysoką wilgotnością, ekstremalnymi temperaturami czy też bezpośrednim, intensywnym działaniem promieni słonecznych.
- Zaleca się montaż po zakończeniu wszelkich innych prac remontowych w miejscu docelowego użytkowania płyty BACKSPLASH.
- Zalecamy aby przed przystąpieniem do obróbki każdą płytę sprawdzić pod względem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych oraz widocznych wad i różnic kolorystycznych.
- Płyta BACKSPLASH to produkt o dużym formacie (4100x640x10 mm), dlatego zalecamy podnoszenie płyt przez dwie osoby. Aby uniknąć uszkodzenia, płyty należy przenosić w pozycji pionowej, podpierając je na dłuższym boku.

Przycinanie na wymiar / wiercenie

- Płyty BACKSPLASH można obrabiać na urządzeniach CNC oraz przy użyciu standardowych narzędzi stolarskich do obróbki drewna, np. piła panelowa, zagłębiarka, otwornica, frezarka górnoprzecionowa, szablony do wycinania otworów. Narzędzia powinny być ostre, co wpływa znacząco na jakość krawędzi. Przed przystąpieniem do obróbki zaleca się dokonanie testów próbnych, aby odpowiednio dostosować parametry narzędzi. Z uwagi na utwardzone obie powierzchnie (laminaty HPL) obróbka płyt BACKSPLASH może prowadzić do szybszego zużycia narzędzi.
- Każdą krawędź po obróbce mechanicznej należy przeszlifować drobnym papierem ściernym w celu wygładzenia krawędzi.
- Po wycięciu i zakończonej obróbce należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci krawędzie wewnętrzne (otwory, miejsca łączenia) środkami wodoodpornymi (np. kleje D3).

Obróbka

- Po zakończonej obróbce (cięcie, frezowanie, łączenie) konieczne należy zabezpieczyć miejsca mechanicznej ingerencji w strukturę płyt BACKSPLASH, w celu zamknięcia ich powierzchni i ochrony przed brudzeniem, ścieraniem oraz wnikaniami wody i wilgoci. W tym celu zalecamy użycie środków wodoodpornych dostępnych w handlu (np. kleje D3).
- Wszelkie widoczne krawędzie, również ze względów estetycznych, należy zabezpieczyć np. obrzeżem ABS, klejonym z użyciem kleju poliuretanowego.

Montaż

- Wszystkie przylegające powierzchnie muszą być czyste i suche. Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na przyczepność i jakość łączenia (środki konserwujące, tłuszcze, oleje, pyły, stare kleje, itp.) muszą zostać dokładnie usunięte.
- Należy wyrównać nierówności powierzchni ścian i usunąć wszelkie gniazda, wyłączniki, uchwyty itp.
- Montaż płyty BACKSPLASH można wykonać po zamontowaniu blatu kuchennego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu blatu przed uszkodzeniami (np. włókniną malarską).
- Zalecamy zastosowanie kleju montażowego o wysokiej sile wiązania, np. typu Mamut, przeznaczonego do klejenia płyt drewnopochodnych/HPL do podłoża ściennego, zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
- Klej aplikujemy na leżącą płytę trzymając kartusz w pozycji prostopadłej do powierzchni. Klej aplikujemy pionowymi pasami w odstępach od 10 do 20 cm, w zależności od wagi klejonego elementu.
- Kleju nie należy nakładać w sposób ciągły i nie do samych krawędzi płyty aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza po zamontowaniu. Po dociśnięciu łączonych elementów pozostaje szczelina wentylacyjna o grubości od 2 do 3 mm.
- Po nałożeniu kleju należy docisnąć BACKSPLASH do ściany, równomiernie na całej powierzchni płyty.
- Połączenia/szczeliny między płytami BACKSPLASH (narożne), na styku z blatem kuchennym oraz wokół otworów instalacyjnych należy uszczelnić np. silikonem.

Ważna uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę montując płyty BACKSPLASH przy płytach gazowych. Ze względu na otwarte płomienie, powierzchnię płyt BACKSPLASH należy zabezpieczyć szybą ESG odporną na

wysokie temperatury. Dodatkowo, rekomendowana odległość od kuchenki gazowej to min. 15 cm od obrysu palnika gazowego (z uwzględnieniem, że ogrzewane naczynie oraz płomień pod nim nie przekraczają obrysem krawędzi kuchenki).

BHP i ochrona zdrowia

Podczas wszystkich prac z płytami BACKSPLASH należy przestrzegać zasad BHP oraz stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np.: środki ochrony słuchu, maseczki przeciwpyłowe, okulary ochronne, itp.).

Użytkowanie i pielęgnacja

- Do czyszczenia płyt BACKSPLASH zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Większe zabrudzenia można usunąć np.: roztworem płynu do mycia naczyń. Następnie przemyć powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha.
- Nie należy stosować żadnych środków czystości zawierających substancje agresywne lub żrące oraz środków zawierających dodatki ściierające lub nabłyszczające, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię płyty.
- Przed użyciem każdego środka czyszczącego należy zapoznać się z załączonym do niego opisem, aby mieć pewność czy nadaje się do tego typu powierzchni (HPL).
- Większe zabrudzenia, np.: od flamastra, nikotyny, lakieru do paznokci czy pasty do butów, należy usunąć spirytusem lub rozpuszczalnikiem organicznym (np. aceton), a następnie przemyć powierzchnię płyty czystą wodą i wytrzeć ją do sucha.
- Płyty BACKSPLASH należy chronić przed długotrwałym, bezpośrednim działaniem gorącej pary wodnej, szczególnie w strefach intensywnego gotowania oraz przy czajnikach, ekspresach i innych urządzeniach generujących parę. W tych miejscach należy zapewnić skuteczną wentylację oraz szczególnie dokładnie zabezpieczyć krawędzie, połączenia i miejsca obróbki przed wnikaniem wilgoci. Długotrwałe oddziaływanie pary i wilgoci może negatywnie wpływać na trwałość powierzchni, krawędzi oraz połączeń.